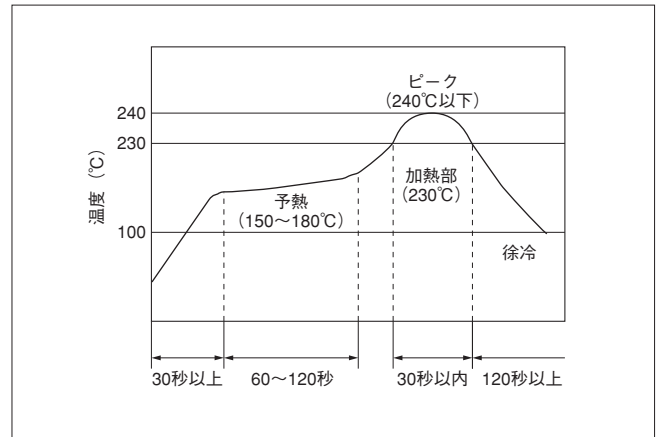


## ●実装上の注意

### 1. 標準はんだ条件

#### (1) リフロー方式

右記プロファイルのリフロー炉に2回通す。



#### (2) こて付け方式

温度+350±5°Cで3.0±0.5秒間当てる。ただし、はんだこて先は電極部に直接接触しないこととする。

#### (3) 実装機について

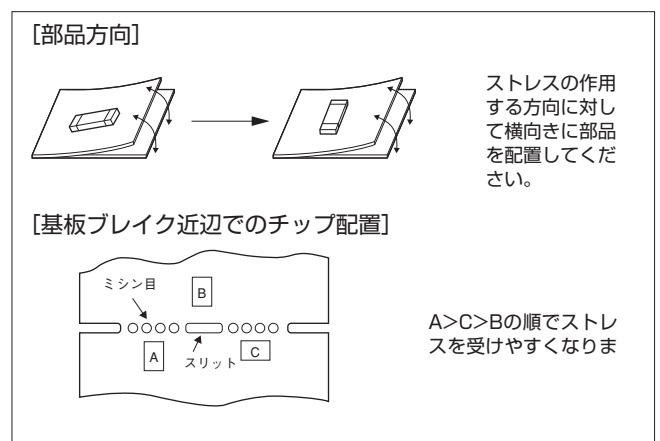
当製品は、画像認識タイプの位置決め機構実装機に対応しています。ただし、実装条件によっては過大な衝撃が加わり製品本体を破損する場合がありますので事前に使用される実装機で必ず評価確認をしてください。なお、メカチャック機構タイプの実装機での実装は避けてください。詳細については事前に当社までお問い合わせください。

#### (4) 注意事項

- 基板に実装された状態で過度の力が加わると不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご注意ください。
- 基板設計の際には、基板のそり・たわみに対して極力ストレスが加わらない様な部品配置にしてください。
- ランド寸法により、部品実装時の機械的強度が異なります。基板設計時にはランド寸法、形状について配慮願います。
- 当製品を基板に実装する際、実装材の位置の爪や吸着ノズル部品が摩擦していると、チップ部品に異常な衝撃が加わり、チップ部品を破壊する事があります。この種のトラブルを事前に防止するためにも、実装機に推奨されている定期メンテナンスを実施してください。
- はんだこてを使用してチップを修正する場合、こてが直接製品にあたらぬよう配慮してください。また、はんだ付け時間が長くなるとはんだくわれが発生することがあります。はんだ付けの際には、銀入りはんだの使用等の配慮をお願いします。
- リフローはんだ付けにおいて、酸性の強い（塩素含有量0.2wt%を超えるもの）フラックスの使用は避けてください。

### 2. 洗浄について

当製品は密閉構造ではありませんので洗浄は避けてご使用ください。



☐ 前ページより続く

### 3. コーティングについて

本体を外装樹脂等でコーティングする場合は、条件を充分ご確認のうえご使用ください。

#### ●保管使用環境

##### 1. 製品保管条件

温度-10～+40℃、相対湿度15～85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管ください。

##### 2. 製品保管期限

製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用ください。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認のうえ、ご使用ください。

##### 3. 製品保管上の注意事項

- (1) 酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けてください。
- (2) 湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管ください。

(3) 直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けてください。

(4) 開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用ください。

(5) 製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取り扱いをお願いします。

##### 4. その他

ご使用に際し、何か不都合が懸念される場合は、別途、当社までご相談ください。

#### ●定格上の注意

過剰な衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご注意ください。

#### ●取り扱い上の注意

1. 製品の測定に際しては、正しくマッチングをとってください。浮遊容量の影響等により、マッチングが正しく取られない場合、規格通りの性能が得られないことがあります。
2. 安全設計のためセラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介してIFアンプに接続し、直接セラフィル®のアース出力間にD.C.印加することは避けてください。